

2023 半導體與資安技術論壇

現今駭客盛行，隨著 AI 的大幅度進步，讓駭客破解帳號密碼的難度大幅度降低。如何保護資訊的機密性、完整性、可用性，是當今重要的課題。本論壇邀集半導體與資訊安全技術相關的產官學研專家學者相聚，藉由專題演講、公開討論進行「人才培育」與「技術開發」之交流。

- 主辦單位：明新科技大學、明新科大半導體學院+圖書資訊處+高教深耕計畫、光電科技工業協進會(PIDA)、台灣化合物半導體暨設備產學聯盟、臺灣半導體產學研發聯盟(TIARA)、長茂科技股份有限公司(EverMore)
- 協辦單位：經濟部工業局、新竹工業區、幼獅工業區、工業技術研究院、資訊工業策進會、中華民國電腦商業同業公會全國聯合會、社團法人新竹市企業經理協進會、國家實驗研究院台灣半導體研究中心、教育部育才平臺執行辦公室-國立臺灣科技大學光電半導體工作圈、新竹縣政府、力成科技股份有限公司、矽格股份有限公司、聯鈞光電股份有限公司、辛耘企業股份有限公司、1111人力銀行、杰揚半導體有限公司、南方科技股份有限公司、美達科技股份有限公司、科毅科技股份有限公司、掌宇股份有限公司
- 活動時間：2023年9月21日(星期四) 09:00-13:00
- 活動地點：明新科技大學 管理學院大樓 1樓哈佛講堂
- 活動對象：半導體業界、官、學、研
- 報名方式：線上報名
- 報名網址：<https://forms.gle/wKQy1ALAtRCm96sH9> (已開放報名)

時程表

時間	活動內容	講者
09:00~09:30	報到	
09:30~09:45	介紹來賓 致歡迎詞	明新學校財團法人明新科技大學 劉國偉校長 資訊工業策進會 資安科技研究所何玲玲所長 中華民國電腦商業同業公會全國聯合會 孫騰源理事長 許順發顧問
09:45~10:00	半導體與資訊安全技術的重要性	長茂科技股份有限公司 黃誌銘董事長
10:00~10:10	資訊安全軟體捐贈	長茂科技股份有限公司 明新科技大學
10:10~10:15	大合照	
10:15~10:45	數位產業推動策略與作法	數位發展部數位產業署 呂正華署長

10:45~11:15	晶片資安威脅探討	資訊工業策進會 資安科技研究所陳智偉副主任
11:15~11:45	資安技術如何克服半導體產線資安治理的挑戰議題	工業技術研究院 資通所卓傳育組長
11:45~12:15	綜合討論	
12:15~13:00	午餐・賦歸	

- 長茂科技股份有限公司將捐贈明新科技大學 TekPass 資訊安全軟體，價值 400 萬元。長茂科技公司專注於資通訊安全技術，是一家提供資訊安全解決方案的軟體開發公司。公司獨特又創新的強式多因子認證安全技術開發出安全又簡單使用的 TekPass 軟體，基於物聯網軟硬體及設備服務的資訊安全架構，採用零信任機制有效地部署解決方案服務於消費者與企業市場，為物聯網軟硬體整合的數位生活提供基礎資訊安全防護。
- 工業技術研究院攜手台積電等逾 30 家廠商制定半導體設備資安標準，於 2022 年公布 SEMI E187 半導體設備資安標準，為少數由台灣主導制定的國際標準，後續影響半導體設備產業深遠。工研院資通所組長卓傳育榮獲 2023 年 SEMI 國際標準貢獻獎殊榮。



資策會資安科技研究所 何玲玲所長



中華民國電腦商業同業公會全國聯合會 孫騰源理事長



數位發展部數位產業署 呂正華署長



資策會資安科技研究所 陳智偉副主任



工業技術研究院資通所 卓傳育組長